

聚酰亚胺先进微细加工材料 TZ3300

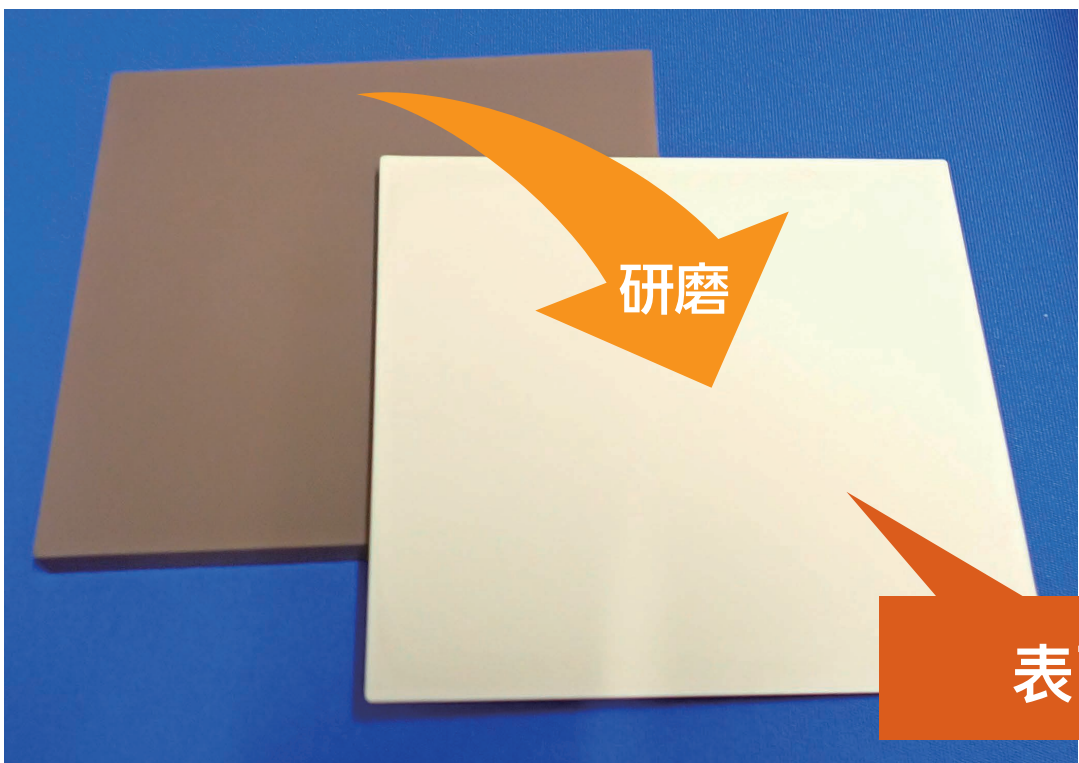


陶瓷增强型PI材料—适用SOCKET测试座、探针卡、PCB检查治具

具有优异微孔加工和高温尺寸稳定性的新型树脂基底材料

特 性

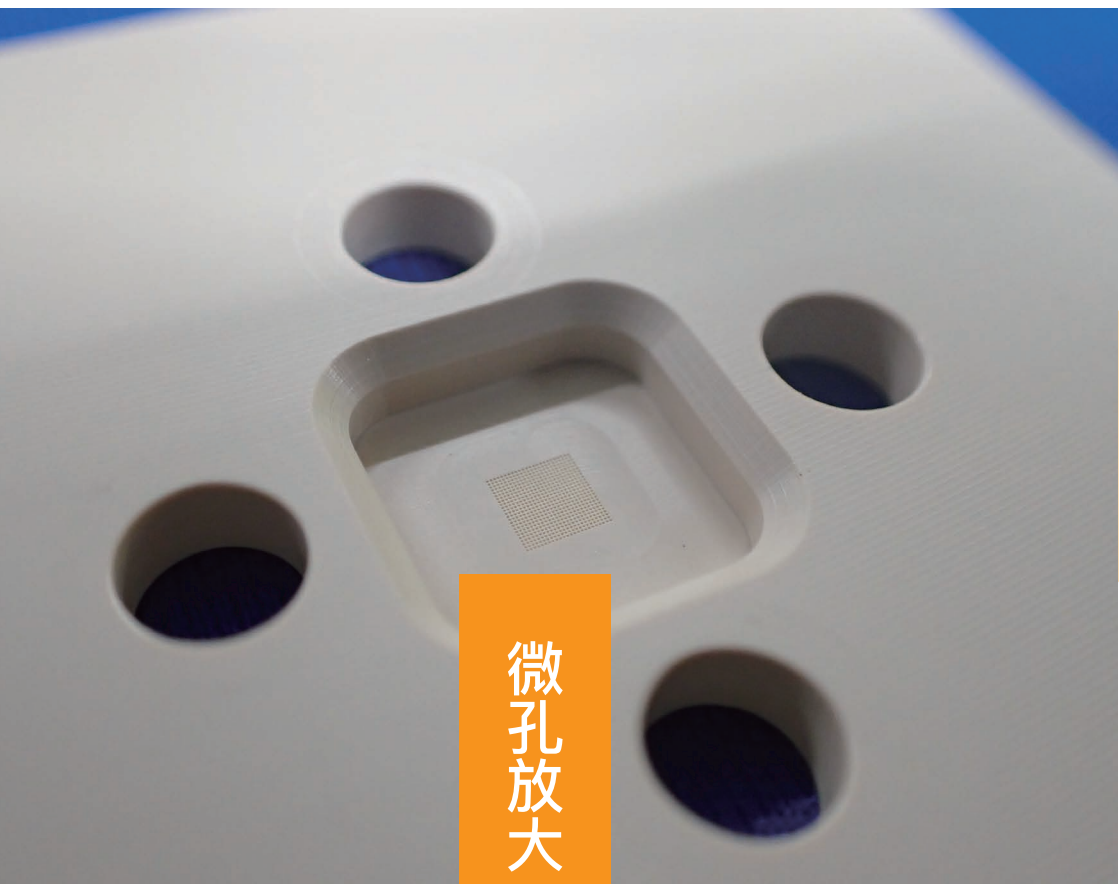
- 可实现Pitch 100μm以下的微孔加工。(最小孔径17μm)
- 可进行机械钻孔和激光加工
- 加工毛刺更少
- 使用了高耐热性的PI, 具有优异的尺寸稳定性
- 具有优异的绝缘性能, 适用于大电流设备
- PI材料, 吸水率低



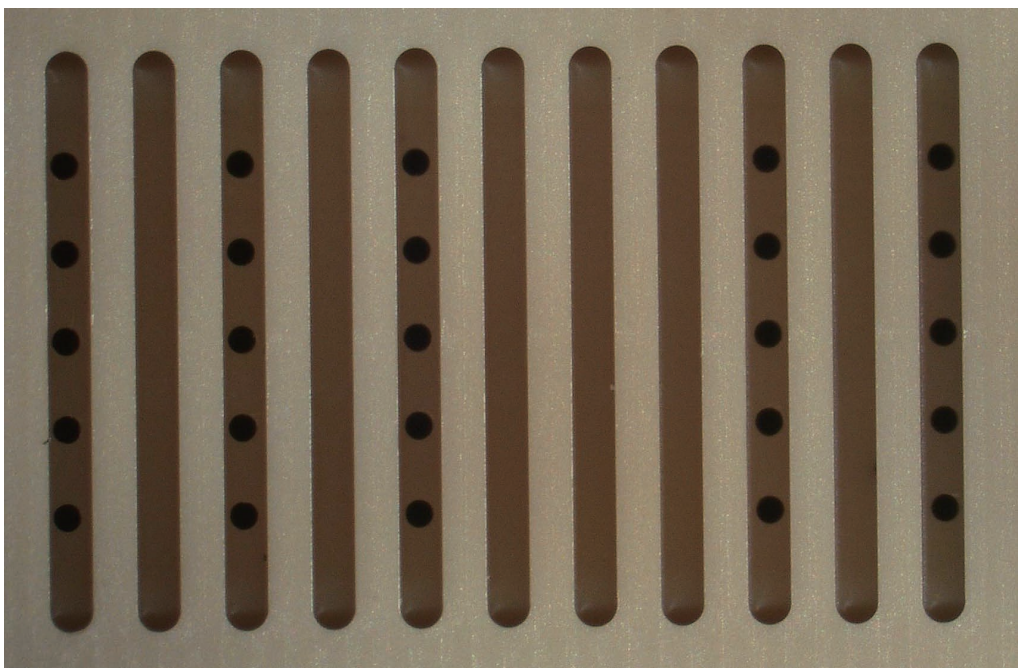
- 70mm 方形×4mm厚
- 100mm方形×6mm厚
- 200mm方形×10mm厚
- 特供品客户可指定厚度 (>0.4mm)
- 可提供最大尺寸:500mm方形

基本特性

机械钻孔加工性能

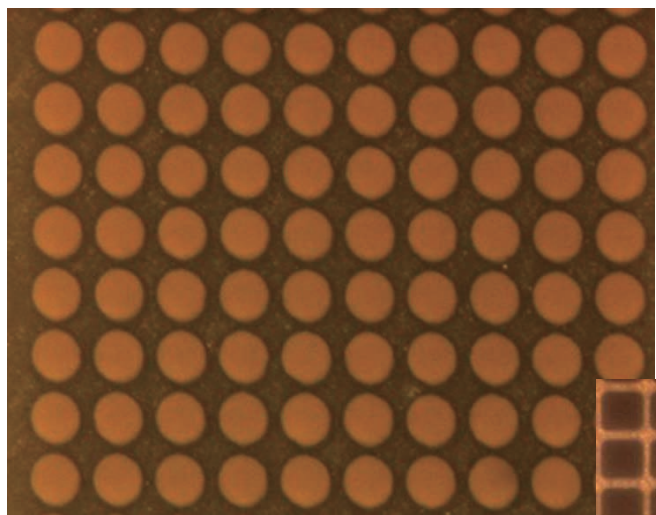


具有优异的微加工性、尺寸精度高！



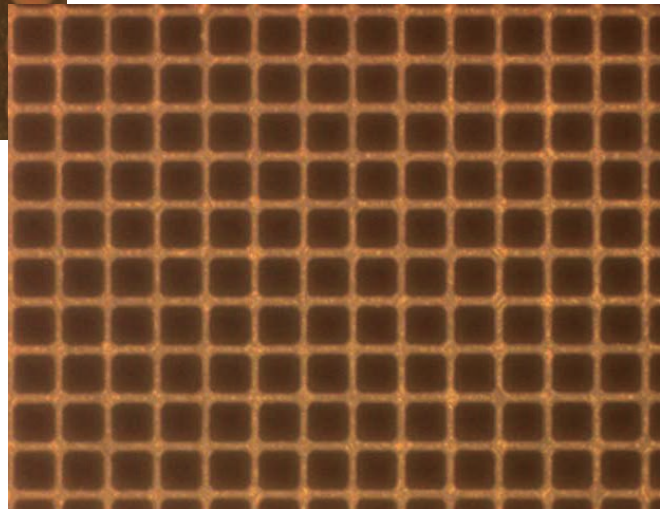
可长孔加工, 线宽120μm

雷射加工性能



- Φ20μm / pitch 26μm
- 无毛刺或碎屑

- 30μm/边
- 隔板厚度 7μm
- R5的精度
- 无隔板塌陷,毛刺少



材料特性

	条件	单位	TZ3300
抗弯曲强度		MPa	140
弯曲强度 Flexural Strength		GPa	4.4
洛氏硬度		—	R125
介电常数(Dk)	10GHz	—	3.4
Loss Tangent(Df)	10GHz	—	0.004
体积阻抗		Ω · m	4×10 ¹³
表面阻抗		Ω	3×10 ¹⁵
CTI		V	600
吸水率	24小时浸泡	%	0.06
CTE	50~200℃	ppm	59

适用超过150℃的高温环境！

